

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）于2020年11月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于向北京农商银行工体支行申请综合授信额度的议案》。公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

为进一步满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向北京农商银行工体支行申请综合授信额度5000万元，授信期限为1年。

上述综合授信额度、业务品种以及授信期限最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司实际经营需求确定，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。此次授权有效期限为：自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起至银行授信期限内有效。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2020年11月26日